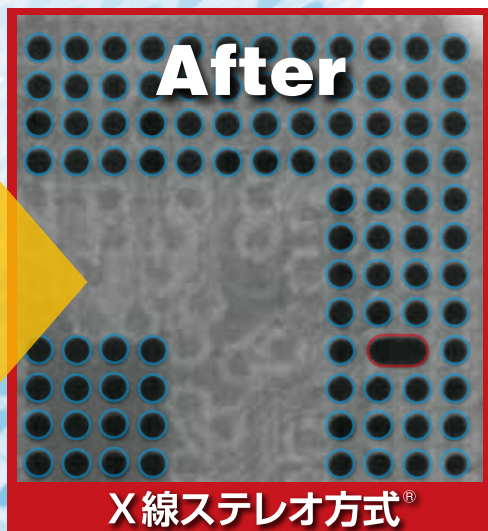
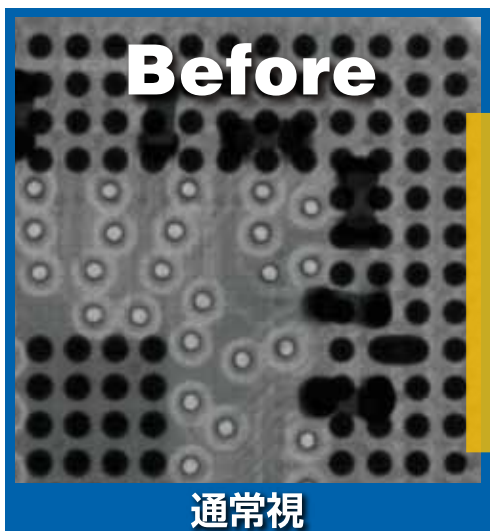


CT方法  
高価格  
遅い

# そこで第3の検査方式 「X線ステレオ方式<sup>®</sup>」

ラミノ方法  
画像がボケる  
高価格



実装基板の表裏が重なって検査が難しい

BGAのはんだ接合部の自動検査が可能

「X線ステレオ方式<sup>®</sup>」により、BGA面とチップ面を切り分けて自動検査

## オフラインX線自動検査装置 **FX-300tRX**

BGA裏面のチップ部品等は、従来の透過方式ではノイズ成分となり正しい検査が困難でした。このたびI-BITが開発したFX-300tRXは、独自の「X線ステレオ方式<sup>®</sup>」を用いることで、BGA、LGA、QFN等、はんだ接合部を直視できない部品や両面実装基板の検査を可能になりました。従来のX線CT方式と異なり、断層画像を必要としないため高速検査が可能です。



●装置寸法・重量 : 1300(W)×1150(D)×1450(H)mm・1100kg

※X線ステレオ方式は、株式会社アイビットの登録商標です。